(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2010 年 12 月 29 日(29.12.2010)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2010/150487 A1

(51) 国際特許分類:
C08G 59/62 (2006.01) *C08L 65/00* (2006.01)
C08K 3/00 (2006.01) *H01L 23/29* (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01) *H01L 23/31* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2010/003990

(22) 国際出願日: 2010 年 6 月 16 日(16.06.2010)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2009-148048 2009 年 6 月 22 日(22.06.2009) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川２丁目５番８号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 和田雅浩 (WADA, Masahiro) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川２丁目５番８号住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 速水進治 (HAYAMI, Shinji); 〒1410031 東京都品川区西五反田７－９－２ 五反田ＴＧビル９階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

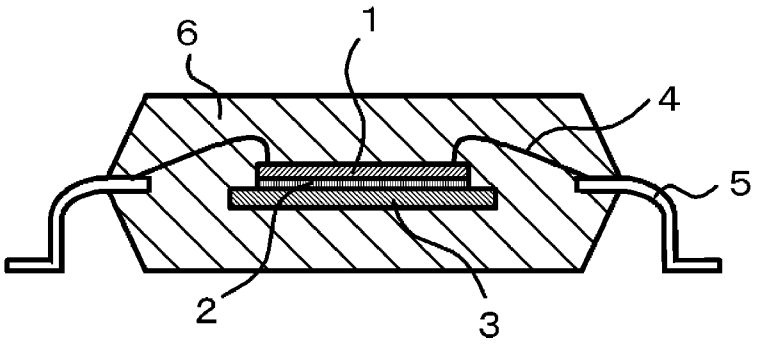
添付公開書類:
— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）

WO 2010/150487 A1

(54) Title: RESIN COMPOSITION FOR SEALING SEMICONDUCTORS, AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称 : 半導体封止用樹脂組成物、及び半導体装置

[図1]



(57) Abstract: Provided is a resin composition for sealing semiconductors comprising a hardening agent, an epoxy resin (B), and an inorganic filler (C), that is characterized in that the hardening agent is a phenolic resin (A) with a predetermined structure. Also provided is a semiconductor device characterized in that a semiconductor element can be obtained by being sealed with the hardened material of the resin composition for sealing semiconductors.

(57) 要約: 硬化剤と、エポキシ樹脂（Ｂ）と、無機充填剤（Ｃ）と、を含む半導体封止用樹脂組成物であって、硬化剤が所定の構造を有するフェノール樹脂（Ａ）であることを特徴とする半導体封止用樹脂組成物、ならびに、その半導体封止用樹脂組成物の硬化物で半導体素子を封止して得られることを特徴とする半導体装置。